

国立台北科技大学 半導体プロセス及び装置 学士プログラム

International Bachelor Program of Semiconductor Process
and Equipment

2025

半導体とは？

半導体とは？

「半導体」という言葉が持つ2つの意味

(1)物理的な意味

電気の流れやすさが、導体と絶縁体の中間の物質

◆電気の流れやすさ

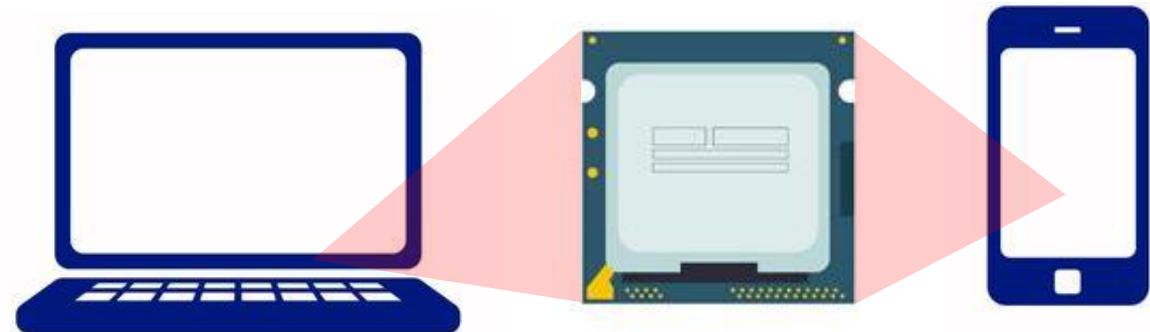
導体 > 半導体 > 絶縁体



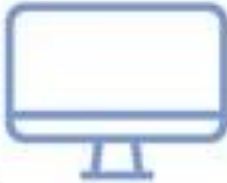
より電気が流れやすい

(2)一般的に使われる意味

電子装置(スマホ、PCなど)の部品としてのIC集積回路 (Integrated Circuit)を指す
= 半導体チップのこと



半導体を人間の部位に例えると

半導体の種類	人間に例えると	機能や役割	用途の一例
ロジック半導体	頭脳	計算、制御、演算	 - コンピュータ - 自動運転
メモリー	頭脳 (記憶)	保存	 - SDカード - SSDストレージ
アナログ半導体	目・耳 (感覚)	音や光、温度などを 感知、デジタル信号 に変換	 - デジタルカメラ - 家電(センサー)
パワー半導体	筋肉	電流や電圧の 変換、制御	 電気自動車



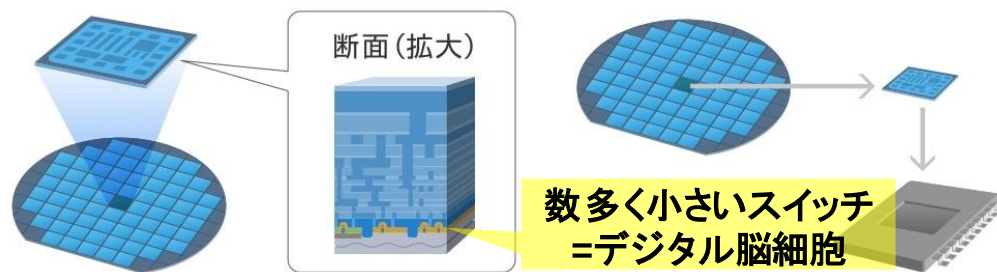
どこで活躍してるの？

PCとスマホの中を見てみると...



基板上に多くのIC(黒いパッケージ)を配置

ICの中に半導体チップとは



シリコンウェハ上に作られます

ウェハから切り分け

<https://www.semiconductor-industry.com/semiconductor/>



現代生活には半導体がないと成り立ちません！

未来の半導体応用



衛星通信



自動運転技術



電気自動車



AI人工知能



IoT

半導体が、未来を切り拓く。

こんな人におすすめ

半導体産業が求める人材像

技術職は主幹



多言語能力

- ・ 英語
- ・ 華語(中国語)
- ・ 日本語
- ・ 等々



重要スキル



即応力: 変化の速い現場でスピーディに対応



実践力: 操作から学ぶ教育、先端技術を実感して身につく



理解力: 工程全体を把握した判断力

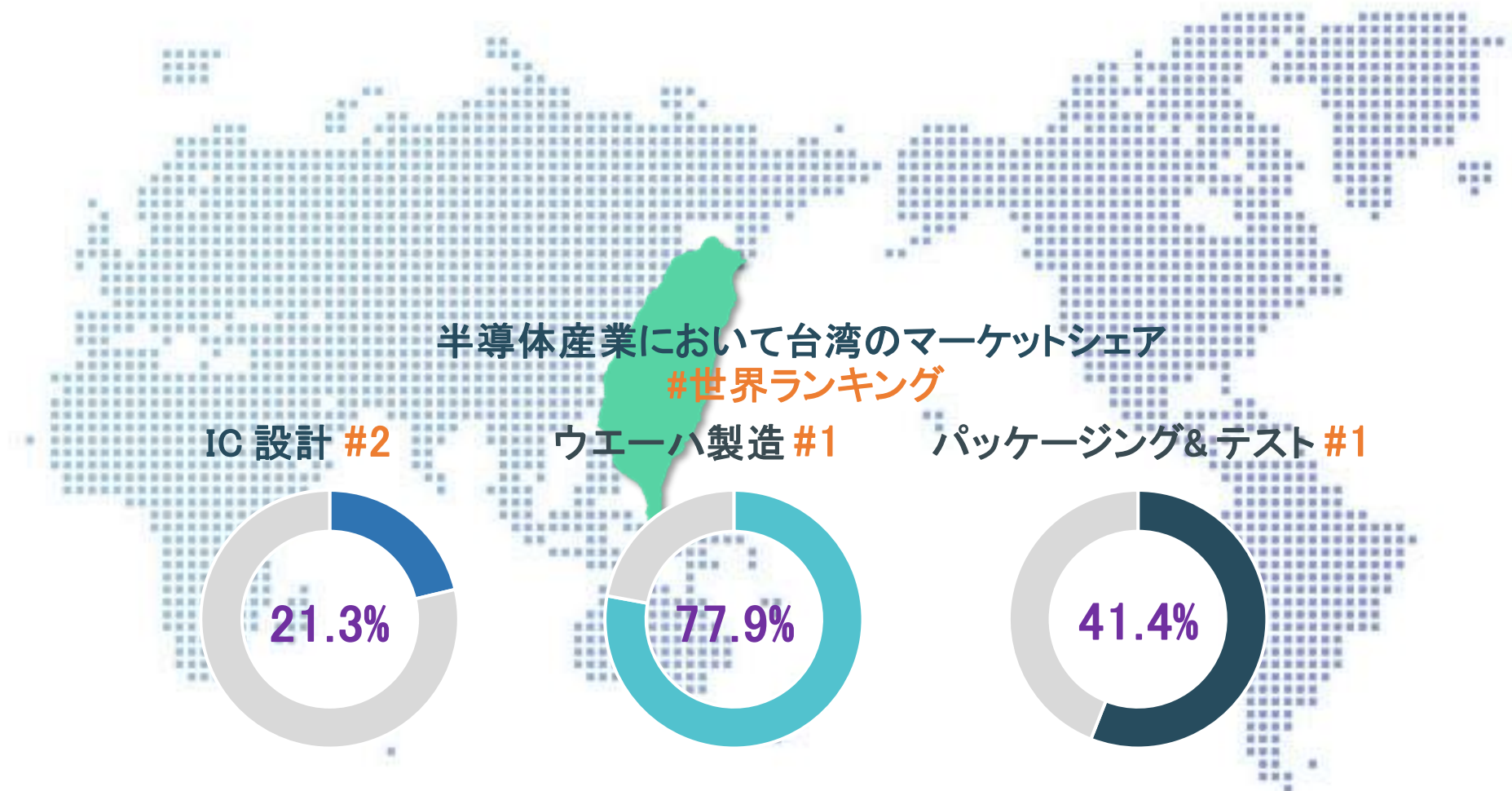
Taipei Tech × 半導体産業との高い親和性

製造現場では知識以上に柔軟性とコミュニケーション力が重要。**科技大生**の実務経験と現場適応性が高く評価されています。

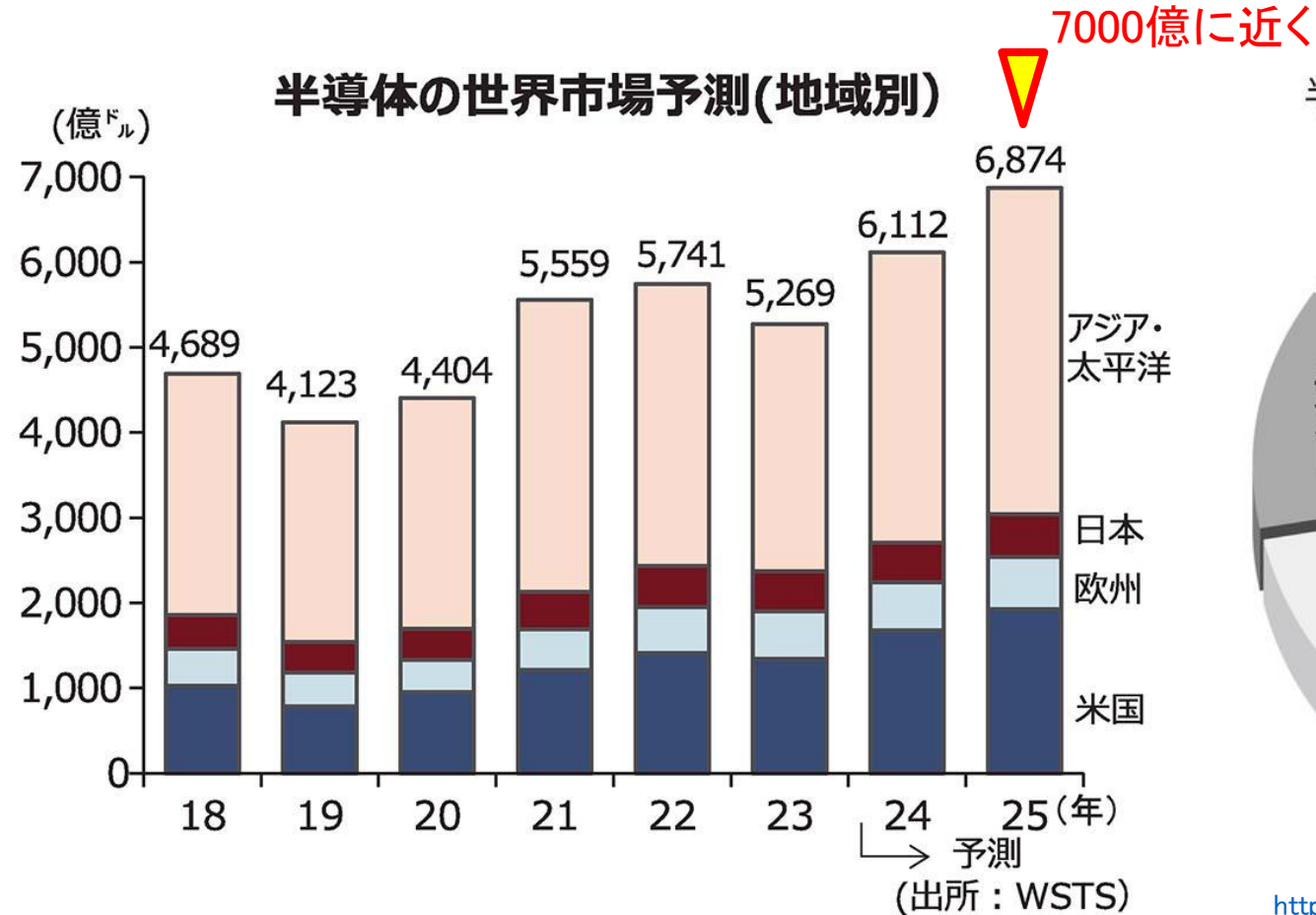
なぜ半導体留学は台湾でない？

世界は台湾の半導体産業に支えられている

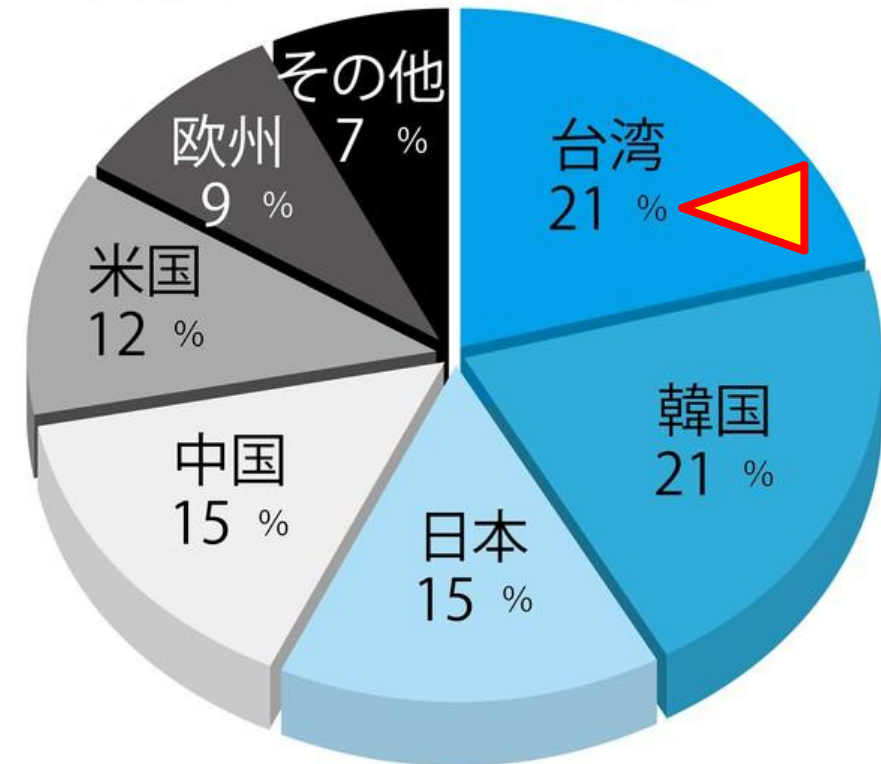
台湾には半導体産業の材料、装置、製造、IC設計など多方面において世界最先端の開発技術と環境が集まっています。



台湾：半導体生産の重鎮



半導体生産はアジアが世界の7割を占める



<https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/12/be8535a24596100e.html>

出典: JETRO(日本貿易振興機構)

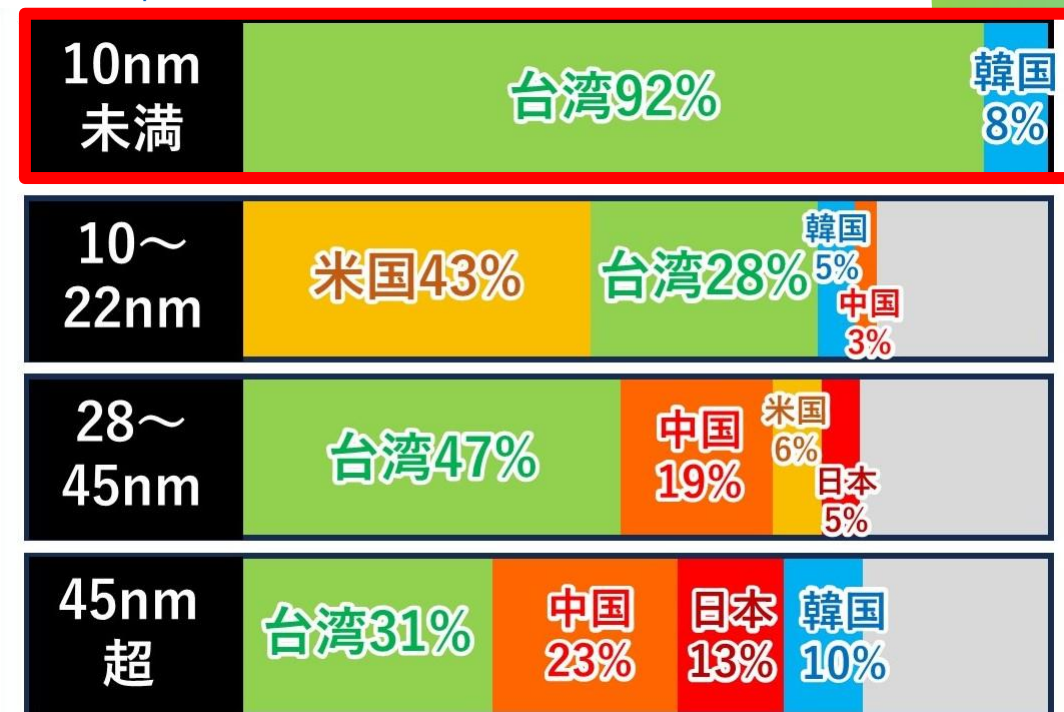
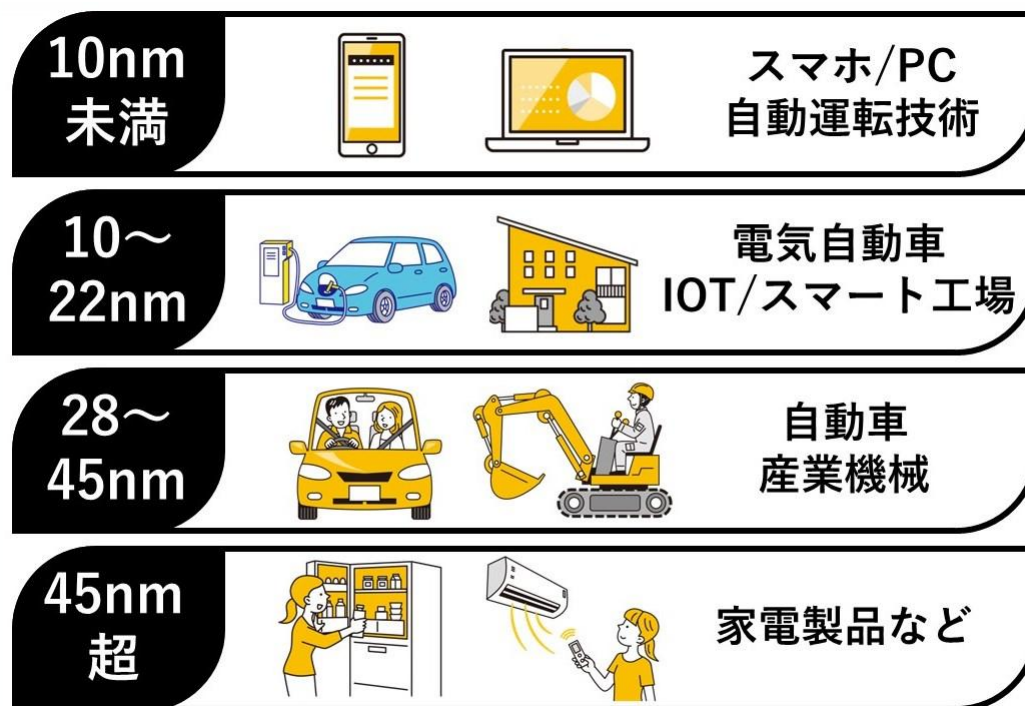
台湾の世界シェアが少なく見えますが、実は…

最先端技術の開発センター

「プロセス微細化 = 半導体進歩の核心」

ナノメートル単位の微細化技術により、小型・高性能・省エネを同時実現

<https://botanicalschool.com/?o=2192197627201&channel=131a2c>



同じ半導体でも、最先端技術の開発プロセスは台湾に集中している。

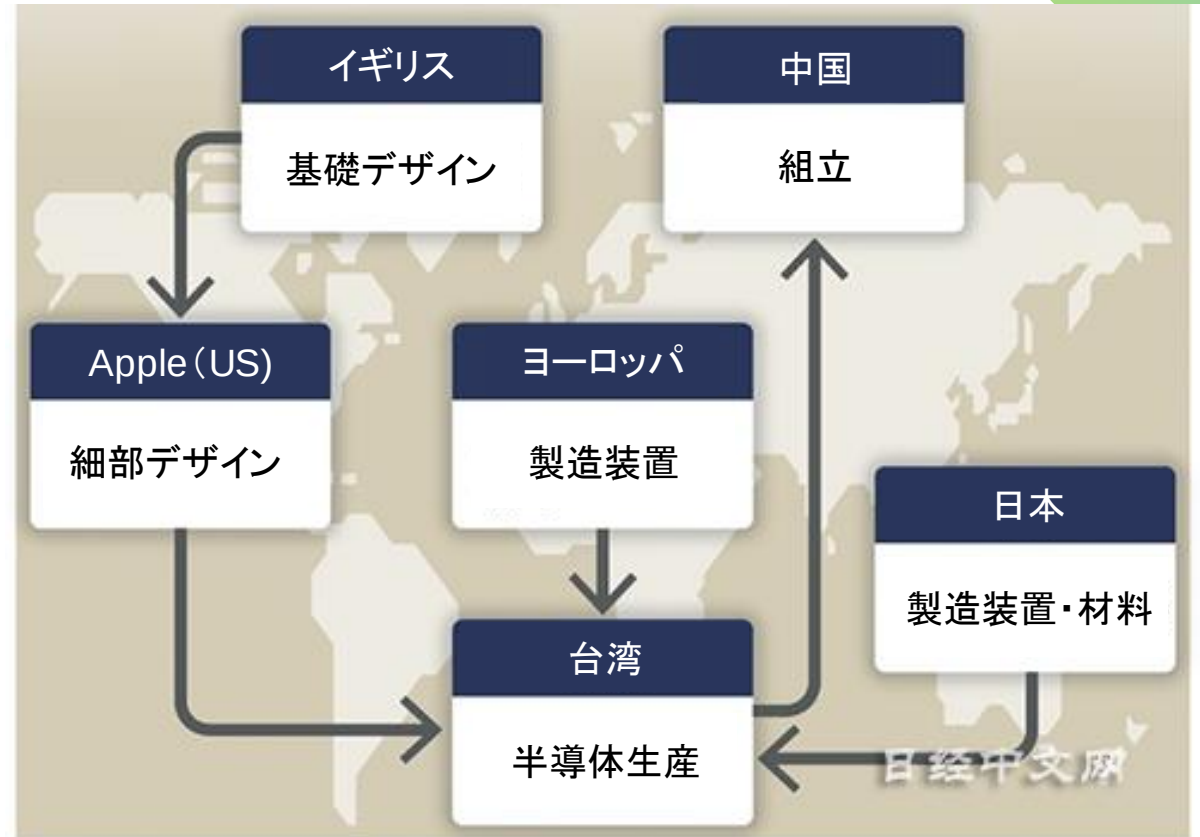
半導体キャリアパスの魅力

世界中が連携しなければ生み出せない半導体

身に近いiPhone



グローバル化生産

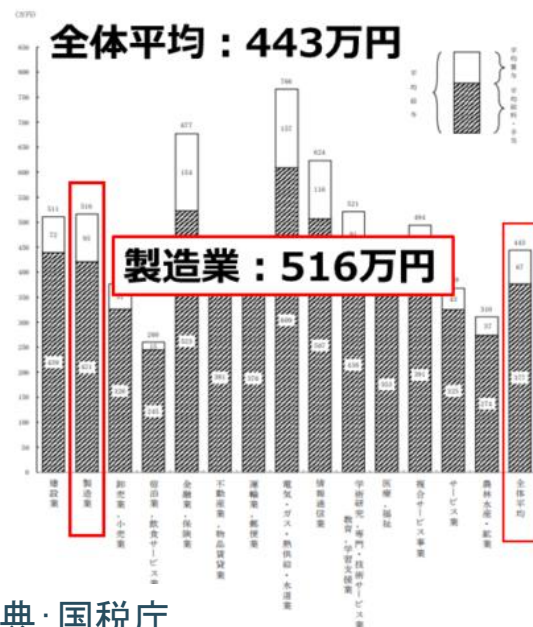


<https://www.semiconductor-industry.com/semiconductor/>

半導体の**専門知識・技術**に加え、**英語・中国語・日本語**を使いこなせる人材は、今後ますます求められる貴重な存在です。

半導体業界の年収は比較的に優れている

日本の平均年収



一般製造業: 500万円前後。主に生産・技術系の業務が中心で、年収水準は中程度。

台湾の半導体産業平均年収



2024年では円換算で約**950**万円

半導体関連の知識やスキルを持つ人材は高い給与ポテンシャルを有している。

半導体業界の年収は学歴/業種に関わる

大手半導体メーカー：TSMCを例に

設備エンジニア

年収：景気によると、大体**24-48ヶ月分**基本給に相当

(給与の内訳：基本給(14ヶ月)、**シーズンボーナス(12-24ヶ月)**、年末賞与、残業代など)

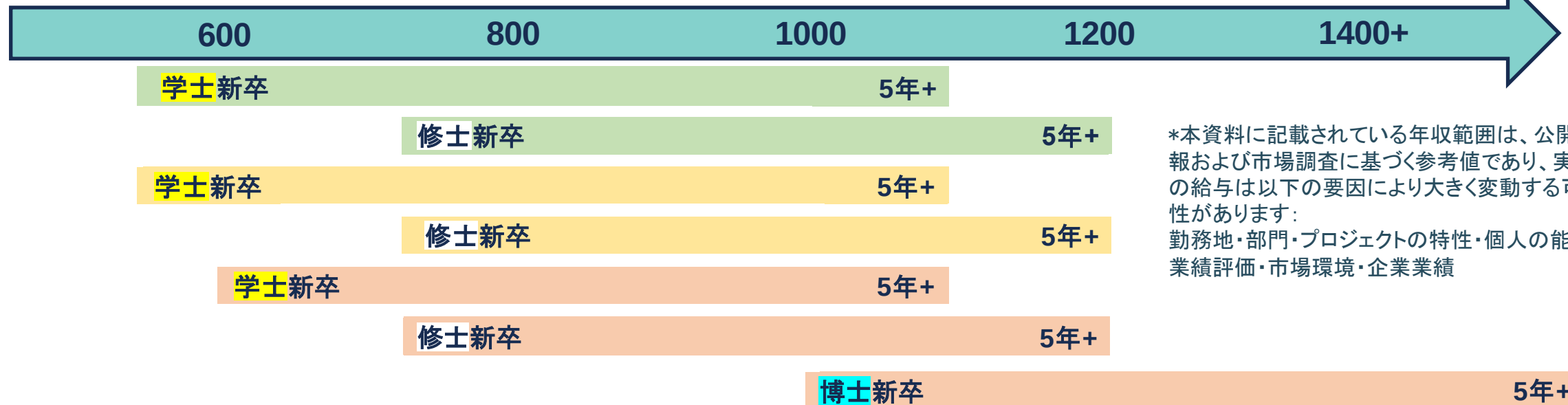
プロセス(工程)エンジニア

学士・修士：**設備・プロセス**エンジニア職が多い

R&D研究開発

一部の修士・博士：**R&D**職

半導体メーカー年収(万円)の目安(JPY)*



*本資料に記載されている年収範囲は、公開情報および市場調査に基づく参考値であり、実際の給与は以下の要因により大きく変動する可能性があります：

勤務地・部門・プロジェクトの特性・個人の能力・業績評価・市場環境・企業業績

現場での評価によると、ボーナスが大きく変動(幅は年収の20-30%)

5年で年収1000万円達成可能(80%以上)。

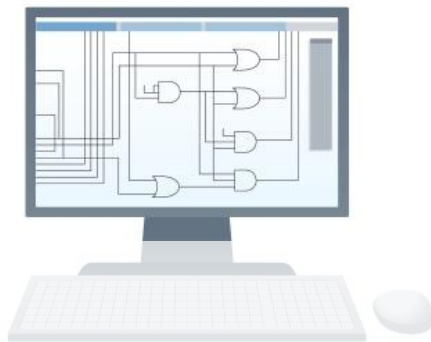
グローバルキャリア展開

設計

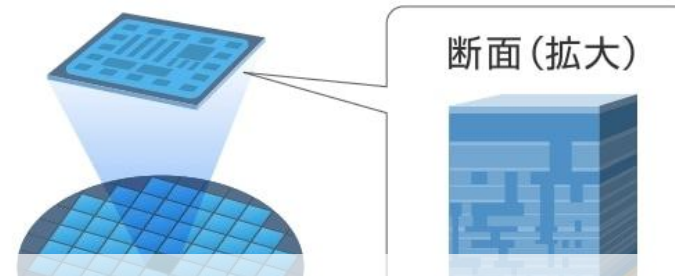
前工程

後工程

<https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/knowledge/semiconductor/room/manufacturing/process.html>

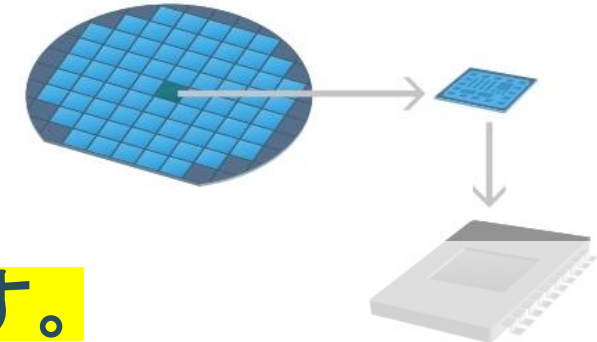


半導体デザイン

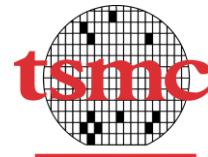


台湾から、世界へ踏み出す。

半導体製造工程(微細加工)



半導体チップの梱包(OSAT)



グローバルキャリア展開

JP 日本

Shin-Etsu(信越化学) | 素材メーカー

JSR | 素材メーカー

TEL(東京エレクトロン) | 装置メーカー

DISCO | 装置メーカー

JASM | 前工程

US アメリカ

Applied Materials | 装置メーカー

Micron | 前工程・DRAM・NAND

Amkor | 後工程(OSAT)

Lam Research(アメリカ) | 装置メーカー

NL オランダ

ASML | 装置メーカー(EUV露光装置)

TW 台湾

TSMC | 前工程

UMC | 前工程

ASE | 後工程(OSAT)

SPIL | 後工程(OSAT)

PTI | 後工程(OSAT)

KR 韓国

Samsung | 前工程・メモリ

CN 中国

JCET | 後工程(OSAT)

専門技能 × 多言語対応力
→ 技術職からグローバル職種
まで、世界中で活躍できる！



国立台北科技大学を選ぶ理由

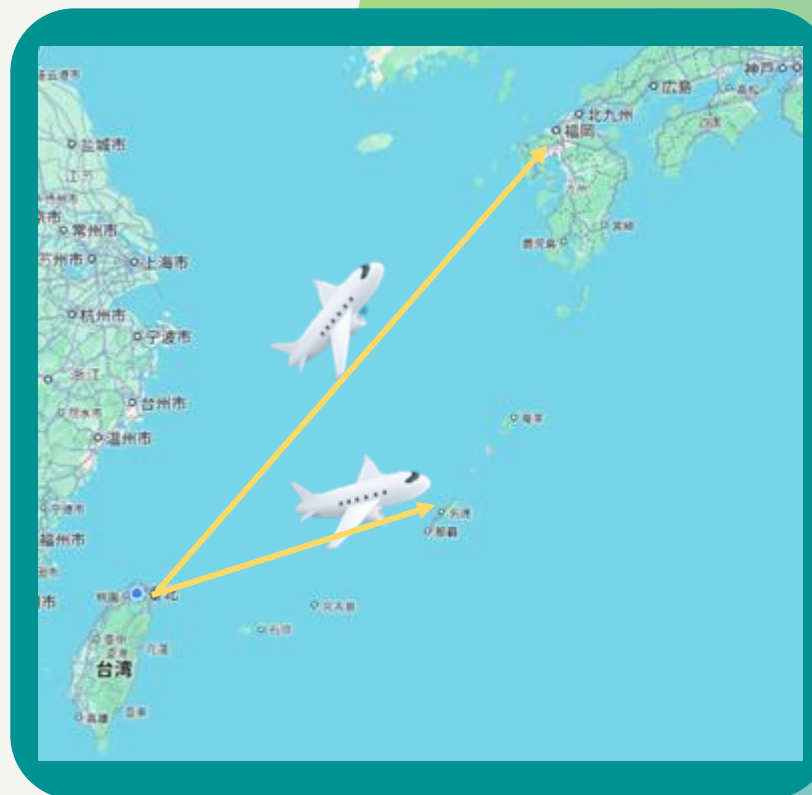
首都の中心部に位置し、通学にも留学生活にも便利な立地



台北の中心部に位置



九州/沖縄から台北まで、
たった**1.5-2.5時間**です！



国立台北科技大学を選ぶ理由

QS World University Rankings by Subject 2024: Engineering & Technology

Discover the best universities in the world for studying engineering & technology with the QS World University Rankings by Subject 2024.

Rank
=216



Waseda University
◎ Tokyo, Japan

Rank
=244



National Taipei University of Technology
◎ Taipei City, Taiwan

Rank
=282



Keio University
◎ Tokyo, Japan

2025年 QS世界大学ランキング(分野)

工学と技術
#244 (台湾第4位)

化学工学
#99 (台湾第2位)

機械工学
#134 (台湾第2位)

材料科学
#121 (台湾第3位)

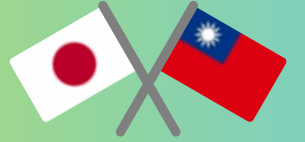
国立台北科技大学を選ぶ理由

起業家の発祥地

上場台湾企業の責任者のうち**10%が**
台北科技大学の卒業生で、台湾企
業の中堅人材を多く生み出しています。



「企業が最も採用したい大卒生」2025
台湾全体ランキング**6**位
公立技職部門**1**位



4年制學位

半導体プロセス及び装置学士プログラム

日本人学生限定の特別クラス

半導体プロセス及び装置学士プログラム

01 専門科目

04 就職支援

02 英語・華語教育

05 生活・学習支援

03 大手企業インターンシップ

06 給付型奨学金

専門科目授業:

半導体業界の**大手企業が求める人材像**に対応したカリキュラムを編成。

主に**工程・設備・工務**の分野を体系的に学び、現場で役立つ実践的な知識を深める。

※専門科目の授業はすべて英語で行います。

本プログラムで履修できる
半導体業界のニーズに対応した実践的専門科目

学年	コアコース(*:必須)	単位/時間
2	半導体分子材料とプロセス	2/2
	半導体膜の特性と測定プロセス	3/3
3	半導体プロセス技術(上/下)*	6/6
	半導体プロセス技術実習(上/下)*	2/6
	学外実習(インターンシップ)*	2/40
4	集積回路製造プロセスの先端技術と装置	3/3
	半導体装置の基礎(TSMC NTC)	2/2
	半導体の先端設備と主要部品	3/3
	半導体装置コンポーネントの基礎(TSMC NTC)	2/2

本プログラムの**特徴**：

4年生専門科目のうち、以下の2科目は**TSMCの新人研修センター** (Newcomer Training Center, NTC) で開講されます。

- 半導体装置の基礎
- コンポーネントの基礎

実際に産業現場で活躍するTSMC講師から、実務に直結する知識を学べる貴重な機会になる。



プログラム特徴

01

専門科目

02

英語・華語教育

03

インターンシップ

04

就職支援

05

生活・学習支援

06

給付型奨学金

02

英語・華語教育

英語学習

1年目：

英語コミュニケーションおよび応用
英語の授業により、「聞く・話す・
書く・読む」4技能を統合的に強化

2年目：

専門英語コースにて、各専門科目
と連携した語彙・表現を習得 → 学
術的内容を英語で理解・発信する
力を養成

学年	英語コース
1	英語コミュニケーションと応用(1)
	英語コミュニケーションと応用(2)
2	専門英語(1)
	専門英語(2)
3-4	各種の半導体専門科目で語学力を実践

目標：専門的な知識や課題に英語で対応
できる実践力の育成

02

英語・華語教育

華語教育

1年目：華語の「聞く力」と「話す力」の基礎を重点的に強化

2～3年目：一般的な華語運用能力を向上させながら、技術系専門用語の理解を深める

専門用語教育（CSP: Chinese for Special Purpose）の構造に基づき、「技術基礎華語－半導体技術」コースを設置

学年	学期	コース名	単位/時間
一年生	上期	ベーシック華語(1)	2/2
		華語と台湾文化の紹介	2/2
	下期	ベーシック華語(2)	2/2
		ビジネス華語	2/2
二年生	上期	ベーシック華語(3)	2/2
		技術基礎華語－半導体技術	2/2
	下期	ベーシック華語(4)	2/2
三年生	上期	ベーシック華語(5)	2/2
	下期	ベーシック華語(6)	2/2
合計			18

目標：中級の華語応用能力を育成

華語・理科基礎強化講義(先行コース)体制

半導体プロセス及び装置学士プログラム 2025年先行コース時間割

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
9:10-10:00	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室
10:10-11:00	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室
11:10-12:00	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室	華語 先鋒502教室
12:00-14:00 昼休み					
14:10-15:00	数学 二教205教室			化学 二教205教室	物理 二教205教室
15:10-16:00	数学 二教205教室			化学 二教205教室	物理 二教205教室
16:10-17:00	数学 二教205教室			化学 二教205教室	物理 二教205教室
各科目担当教師 数学 李政哲先生					

入学前に**華語**と**基礎理科(数学、物理、化学)**の強化講義を**無料**で提供します。

- ・ 華語
- ・ 数学
- ・ 物理
- ・ 化学



大学での専門課程にスムーズに移行できるよう、語学・学習・生活面からの基盤を整えること

プログラム特徴

01

専門科目

04

就職支援

02

英語・華語教育

05

生活・学習支援

03

インターンシップ

06

給付型奨学金

03

大手半導体メーカーのインターンシップ

基準を満たした学生は、大学3年後半に大手半導体メーカーのインターンシップ面接に応募できます。合格者は夏休み期間中に**有給のインターンシップ**に参加し、現場で実践的な経験を積むことが可能です！



プログラム特徴

01

専門科目

04

就職支援

02

英語・華語教育

05

生活・学習支援

03

インターンシップ

06

給付型奨学金

04

就職支援

本校のTSMC連携半導体プログラムでは、修了直前で
TSMCへの就職活動を支援

半導体関連の知識を基に将来的には日本の半導体業界:TEL、JASM、Micron、UMCの日本工場などへの就職も視野に入れます。

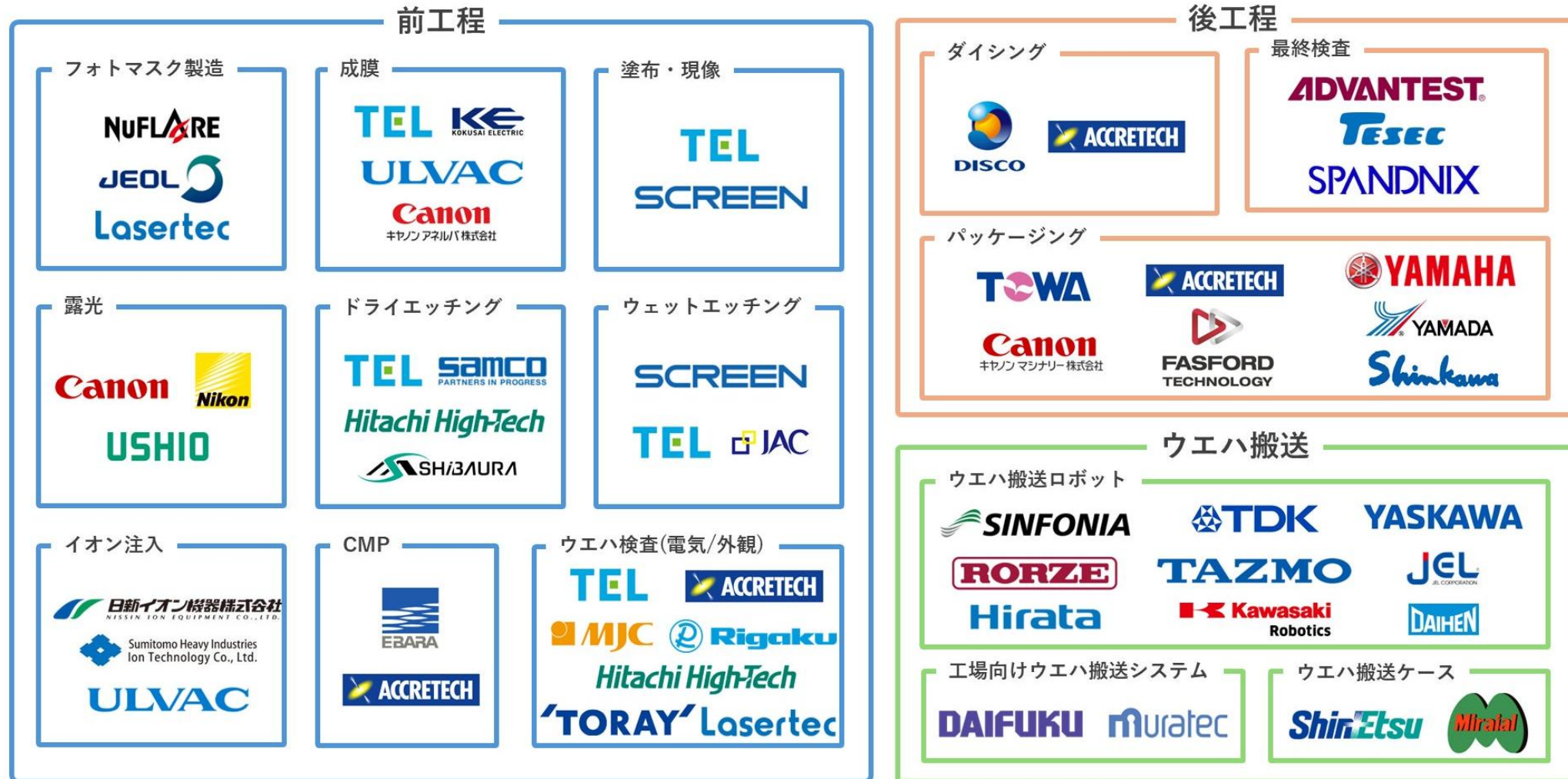


国際学生企業合同採用マッチング会



04

日本の中核製造装置メーカー



<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000149740.html>

半導体需要が上回ることで、キャリアパスも広げてい

プログラム特徴

01

専門科目

04

就職支援

02

英語・華語教育

05

生活・学習支援

03

インターンシップ

06

給付型奨学金

05

学習支援・生活支援

- 学習支援: 日本での経験を持つ**担任教師**と**TA**(指導助手)が日本語でサポート
- 生活面も安心: 日本語対応可能な**学生パートナー**(学伴)や**行政スタッフ**が留学生の生活も全面的バックアップ
- 留学生イベント
多文化が息づくキャンパスで、学生同士の繋がりを深め、学習から生活まで、あらゆる面でサポートし合い、充実した留学生活を送れます。
- 居住: 初年度は**格安学生寮**が確約
※4人部屋; 約58,000円/1学期(6ヶ月)



学生寮

学生の社会力成長促進とコミュニティ形成を促進するため、
アットホームな雰囲気と良質な宿泊環境を提供。※2025年現在築7年

ロビー



閲覧室



フロア共同スペース：
社交ラウンジ、ランドリー、ウォーターサーバー、廊下、エレベーターホール



4人部屋風景



4人部屋(バス・トイレ別)



学生寮外觀



サークル活動



プログラム特徴

01

専門科目

04

就職支援

02

英語・華語教育

05

生活・学習支援

03

大手企業インターンシップ

06

給付型奨学金

06

給付型奨学金/学費免除

「高校総合成績」「英語能力」「前年度の成績」に基づく複合的な条件で最大月額1万台湾ドルの奨学金が支給されます。

さらに、入学金不要で成績による学費免除制度*もあり、経済的な負担が大幅に軽減されます。

*学費:年間11万台湾ドル(約53万円相当)

06

2026年入学の奨学金・学費免除

(30名の場合; **学士1年生**のみ適用)

総合評価	人数上限	給付奨学金 台湾ドル/月額	学費免除
上位25%以内	8	10000	全額
26-50%	8	5000	75%免除
51-75%	8	5000	25%免除
76-100%	—	—	—

- ・ 高校成績、英語能力、自己紹介動画、特殊表現などに基づいて総合的な審査を行うこと。
- ・ 上記のほか、**特段に優れている成績実績**や履修科目など総合的な条件を考慮する場合があります。

*奨学金の支給人数および待遇内容は、当該年度の応募者数や全体の成績分布などを考慮し、評価基準が適切に調整される場合があります。

06

1年目の奨学金の評価要項:2026入学生対象

1. 高校での学業成績

- GPA 4.4以上、または数理科目(数学Ⅲ・C、理科)で4点以上取得が加点の目安

2. 英語能力

- 英検準1級 / TOEIC 785点 / IELTS 6.0 / TOEFL 75点以上の成績が加点の目安
- 上記以外の英語資格はCEFRのB2相当以上が加点の目安

3. 自己紹介動画

- 個性やコミュニケーション能力を重視
- 自己表現力や学習意欲も評価の対象

4. 課外活動での実績

- 部活動やその他の課外活動における顕著な成果を評価
- リーダーシップや取り組み意欲も考慮

審査委員会は、各項目を踏まえ、総合的な判断を行います。なお、本基準は目安であり、極端な個別状況を考慮する場合があります。

本プログラム在学生の体験談

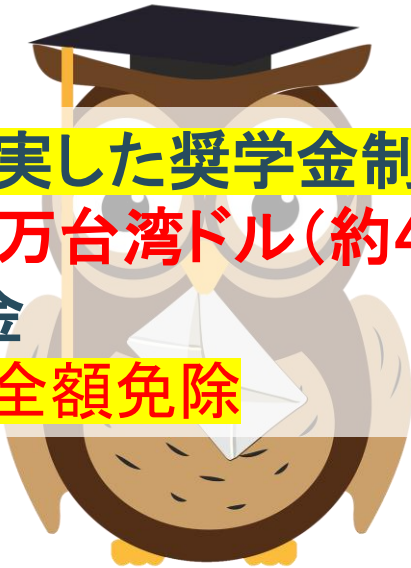
結論

Taipei Techから半導体業界へ

充実した奨学金制度

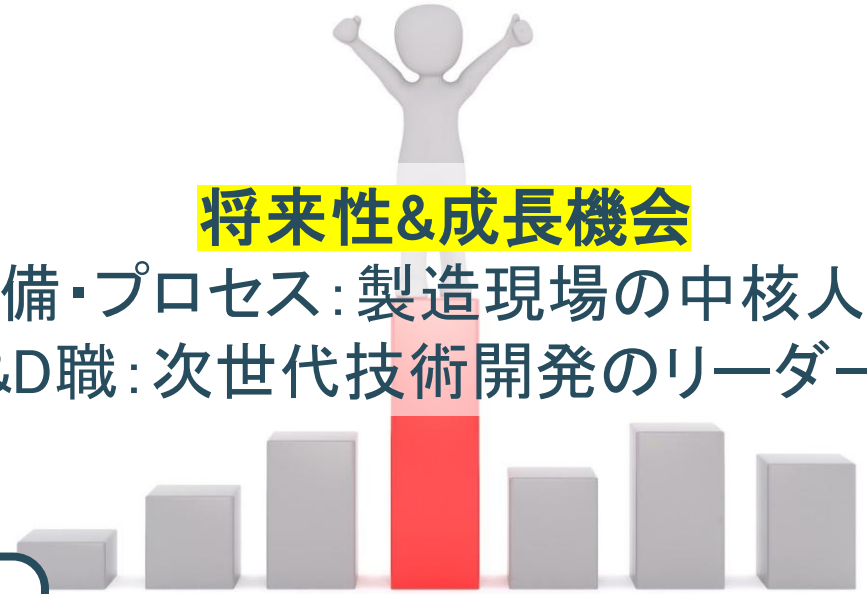
最高月額**1万台湾ドル(約4.8万円)**の
給付奨学金

学費: 最大**全額免除**



将来性&成長機会

設備・プロセス: 製造現場の中核人材
R&D職: 次世代技術開発のリーダー



明るいキャリアパス

新卒: 年収**600-1000万円**



グローバルキャリア

実践育成で専門知識・語学力身に付く
世界中に活躍するキャラクターに!



2026年9月入学 応募日程

一次募集

‘25/9/1～11/15

二次募集*

‘25/12/1～‘26/4/10

*合計で定員30名まで

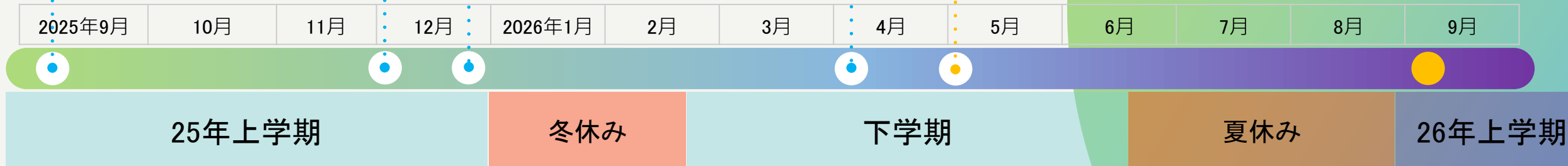
12月下旬:一次合格発表

プレコース ‘26/5～‘26/8

短期語学ビザで先ずは台湾生活に慣れて、
華語 & 基礎科目(数学、物理、化学)を強化
無料で開講! ※生活費・寮費は自己負担

4月中旬
二次合格発表

9月上旬
學期開始
(居住ビザへの切り替え)



応募コード

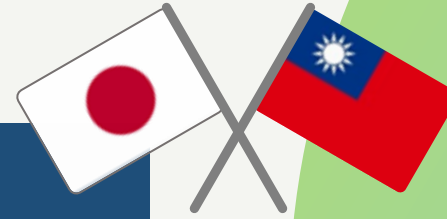


OIAコード



ウェビナー(7月5日)

ここから未来を描こう！
Design your future !





別添

4年制学位-1年生

必須科目				選択科目			
学期	コース名	タイプ	単位/ 時間	学期	コース名	タイプ	単位/ 時間
上期	体育	共通科目	0/2	上期	デジタル論理設計 静力学 台湾の社会と文化	専門科目 専門科目 共通科目	3/3 3/3 2/2
	英語コミュニケーションと応用(1)	共通科目	2/3				
	ベーシック華語(1)	共通科目	2/2				
	一般教養科目	教養科目	2/2				
	微積分学	専門科目	3/3				
	物理	専門科目	3/3				
	物理実験	専門科目	1/3				
	基礎プログラミングと人工知能	専門科目	2/2				
	化学	専門科目	3/3				
	化学実習	専門科目	1/3				
下期	体育	共通科目	0/2	下期	ビジネス華語	共通科目	2/2
	英語コミュニケーションと応用(2)	共通科目	2/3				
	ベーシック華語(2)	共通科目	2/2				
	一般教養科目	教養科目	2/2				
	微積分学	専門科目	3/3				
	物理	専門科目	3/3				
	物理実験	専門科目	1/3				
	化学	専門科目	2/3				
	化学実習	専門科目	1/3				

4年制学位-2年生

付きの授業: 本プログラムの中核科目

必須科目				選択科目			
学期	コース名	タイプ	単位/時間	学期	コース名	タイプ	単位/時間
上期	体育	共通科目	0/2	上期	半導体分子材料とプロセス測定 半導体膜の特性とプロセス 半導体産業概論 技術基礎華語 - 半導体技術	専門科目 専門科目 専門科目 自由選択	2/2 3/3 2/2 2/2
	一般教養科目	教養科目	2/2				
	専門英語	共通科目	2/2				
	ベーシック華語(3)	共通科目	2/2				
	数理工学(I)	専門科目	3/3				
	電気回路 (I)	専門科目	3/3				
	材料科学入門	専門科目	2/2				
	熱力学	専門科目	3/3				
下期	体育	共通科目	0/2	下期	確率 半導体材料及び部品 電気回路 (II)	専門科目 専門科目 専門科目	3/3 3/3 3/3
	一般教養科目	教養科目	2/2				
	専門英語	共通科目	2/2				
	ベーシック華語(4)	共通科目	2/2				
	電子工学(I)	専門科目	3/3				
	電子工学実習(I)	専門科目	1/3				
	数理工学(II)	専門科目	3/3				
	冷凍空調の原理	専門科目	3/3				

4年制学位-3年生

付きの授業: 本プログラムの中核科目

必須科目				選択科目			
学期	コース名	タイプ	単位/時間	学期	コース名	タイプ	単位/時間
上期	ベーシック華語(5)	共通科目	2/2	上期	体育	自由選択	1/2
	実務セミナー(I)	専門科目	2/6		電子顕微鏡学	専門科目	3/3
	機構設計	専門科目	3/3		材料力学	専門科目	3/3
	半導体プロセス技術	専門科目	3/3		自動制御部品の応用	専門科目	3/3
	半導体プロセス技術実習	専門科目	1/3		電磁気学(I)	専門科目	3/3
	シリコンナノデバイス物理	専門科目	3/3		電子工学(II)	専門科目	3/3
					電子工学実習(II)	専門科目	1/3
下期	ベーシック華語(6)	共通科目	2/2	下期	真空システムの理論と実務	専門科目	3/3
	実務セミナー(II)	専門科目	2/6		体育	自由選択	1/2
	クリーンルーム設計	専門科目	1/3		センサーとコンバーター技術	専門科目	3/3
	半導体プロセス	専門科目	3/3		流体力学	専門科目	3/3
	半導体プロセス技術実習	専門科目	1/3		機器分析	専門科目	3/3
					伝熱学	専門科目	3/3
					半導体工場技術	専門科目	3/3

4年制学位-4年生

必須科目				選択科目			
学期	コース名	タイプ	単位/時間	学期	コース名	タイプ	単位/時間
上期	学外実習 (夏休み)	専門科目	2/40	上期	体育 集積回路製造プロセスの先端技術と装置 半導体装置の基礎 (NTC)* 人工知能 実験計画法	自由選択 専門科目 専門科目 専門科目 専門科目	1/2 3/3 2/2 3/3 3/3
下期				下期	体育 半導体の先端設備と主要部品 基礎半導体設備部品(NTC)* ディープラーニング応用開発と実践 薄膜の科学と工程	自由選択 専門科目 専門科目 専門科目 専門科目	1/2 3/3 2/2 3/3 3/3

*付きコース: TSMCの新人研修センター(NTC)で行う授業
 付きの授業: 本プログラムの中核科目

06

2026年入学の奨学金・学費免除

(30名の場合; **学士2年生以降**適用)

成績基準 (前年度)	人数上限	給付 奨学金 台湾ドル/月額	学費免除
上位25%以内	8	10000	全額
26-50%	8	5000	75%
51-75%	8	5000	25%
76-100%	—	—	—

- **大学2年生**以降は、**前年度の総合成績**に基づいて審査を行います。

追伸: この評価基準は、大学3年・4年生への進級にも継続して適用されます。前学年成績により、毎年度見直しが行われ、ランクの再評価が実施します。

応募書類

1	卒業証明書 *新卒者は第一回募集の際、卒業証書を後日提出することができます。	5	パスポートのコピー
2	高校成績証明書	6	推薦状2通
3	英語試験の証明書 (English CEFR B1 または EIKEN Grade 2 以上)	7	自我介绍と志望動機の動画 (英語または華語)
4	財源証明書 (米ドル5,000、約750,000円以上)		

応募書類説明(1/3)

卒業証明書

高校卒業証書を添付してください。卒業証書が華語または英語以外の場合、公証された華語または英語の翻訳を添付する必要があります。新卒生は在学証明書をアップロードできます。***新卒生は第一次募集時に卒業証書を後から提出することができます。**

成績表

高校新卒生は1年目と2年目の成績表をアップロードできます。

言語能力証明

CEFR B1またはEIKEN Grade 2 級の英語検定証明書を提出する必要があります。
(<http://gostudylink.net/en/support/levels>).

財源証明書

750,000円以上（米ドル5,000元以上）、以下のいずれかの方法で提出してください：

1. 最近3ヶ月以内に金融機関が発行した財力証明書。
2. 預金証明が申請者の口座でない場合、(1) 保証人の財力証明書と (2) 入学申請の財力保証書を提出してください。
3. 全額奨学金を受けている証明書。

応募書類説明(2/3)

パスポートのコピー

申請時点でパスポートを所持していない場合は、国籍情報の記載がある住民票で代用することが可能です。

推薦状2通

推薦者は申請者を指導した教師(または勤務先の上司)に限る

自我介绍と志望動機ビデオ

1分以上の自己PRおよび志望動機の説明動画を、英語または華語で作成のうえ、YouTube (限定公開可) にアップロードし、一般閲覧が可能な動画のURLを、PDF形式でご提出ください。

応募書類説明(3/3)- 英語検定成績対照表

CEFR	EIKEN Grade	TEAP	TOEFL		TOEIC
			PBT	iBT	
B1	Grade 2	308-225	450-549	45-79	550-780

オンライン出願方法

www.oiataipeitech.tw
受付期間：25/12/1～26/3/31

今から、未来を掴め！
「半導体製造プログラムと装置」学位コース

2024	2025		
10/01-11/15	02/01-04/30	04/01-08/30	9月上旬
一次募集 12月下旬採用発表	二次募集 6月下旬採用発表	台湾にて中国語を 学び	授業開始

① 登録する ログイン

初めての方は、まず登録をお願いします

Taipei Tech Registration Form - International Bachelor Program of Semiconductor Manufacturing and Equipment

1. Register 登録 → 2. Receive Application ID by Email アプリケーションIDをメールで受け取る → 3. Login ログイン → 4. Upload Documents & Submit Application before November 15. 11月15日までに申請書を提出するための書類をアップロードしてください

HANDBOOK LINK

Intended Field of Study

Degree
Bachelor

First Priority
International Bachelor Program of Semiconductor Manufacturing and Equipment

Second Priority
International Bachelor Program of Semiconductor Manufacturing and Equipment

Personal Information

First Name

Middle Name

②資料を記入する

NTUT Registration Form 外部 收件匣 x

intstudyntut@gmail.com

寄給 我 ▼

Hi, thank you for your interest in the Taipei Tech program. こんにちは。台北工科大学プログラムにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

Please save this ID to sign into the application portal. このIDを保存して、アプリケーションポータルにサインインしてください。

ID:bd873491

③イーメールからIDを受け取る

You can login the Application Portal using your application ID on this link: <https://www.oiataipeitech.tw/english/login>

This email is sent automatically, please do not reply to this email. Thank you.

今から、未来を掴め！
「半導体製造プログラムと装置」学位コース

2024	2025		
10/01-11/15	02/01-04/30	04/01-08/30	9月上旬
一次募集	二次募集	台湾にて中国語を 学び	授業開始
12月下旬採用発表	6月下旬採用発表		

登録する

ログイン

④

初めての方は、まず登録を
お願いします



Application Portal

Login

Applicant ID

bd873491

LOGIN


Instruction


Form Upload


Dark Mode


Logout

List of Documents

Please make sure you have included the following documents when submitting your application.

1. Diploma Certificate


Diploma Certificate

2. Transcripts


Transcripts

3. language proficiency


Proof of Language Proficiency

4. Passport


Passport

5. Recommendation 1


Recommendation Letter 1

6. Recommendation 2


Recommendation Letter 2

6. Recommendation 2


Recommendation Letter 2

7. Financial Statement


Financial Statement

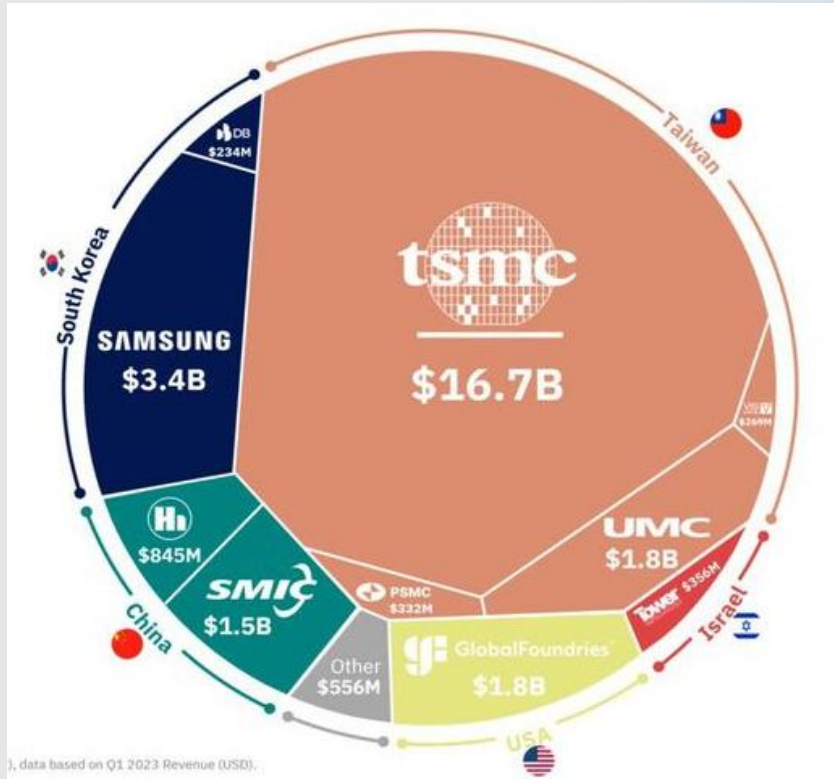
8. Self Intro Video Link


Self intro Video link as PDF

Please do not close this page until the uploading process is complete. アップロード処理が完了するまでこのページを閉じないでください。

SUBMIT





<https://www.all-about-industries.com/the-semiconductor-market-a-c08ea94ecc9354610ddb5928ba681db4/>

